

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2023-032

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临时会议于 2023 年 5 月 8 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2023 年 5 月 10 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》

为了推进公司的市场业务拓展、项目技术研发及全球化生产与投资布局，公司拟在新加坡投资 3,000 万美元设立全资子公司。

《晶方科技关于投资设立全资子公司的公告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日